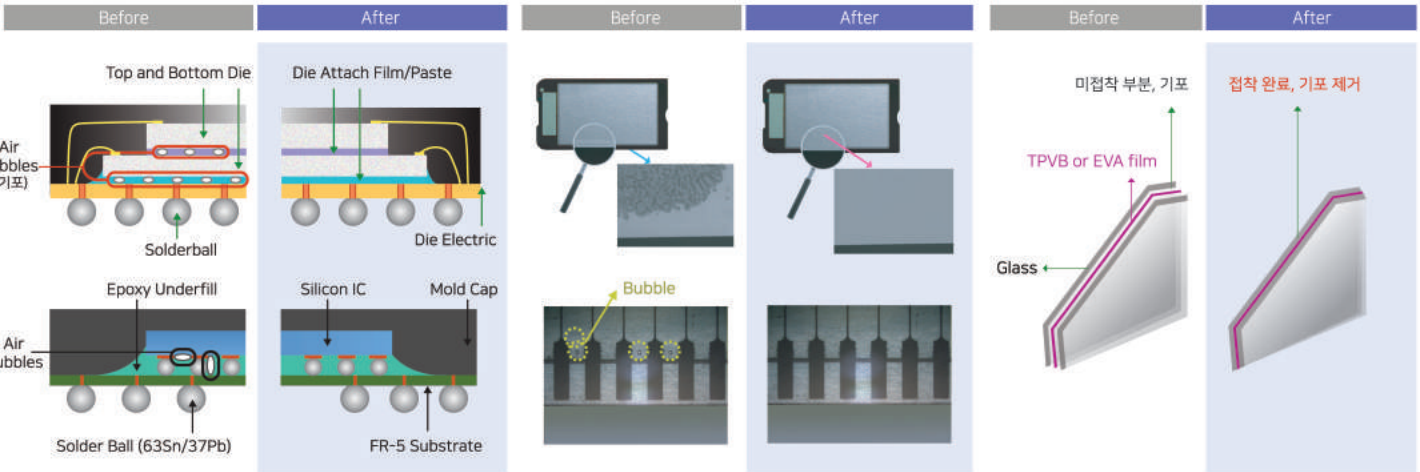
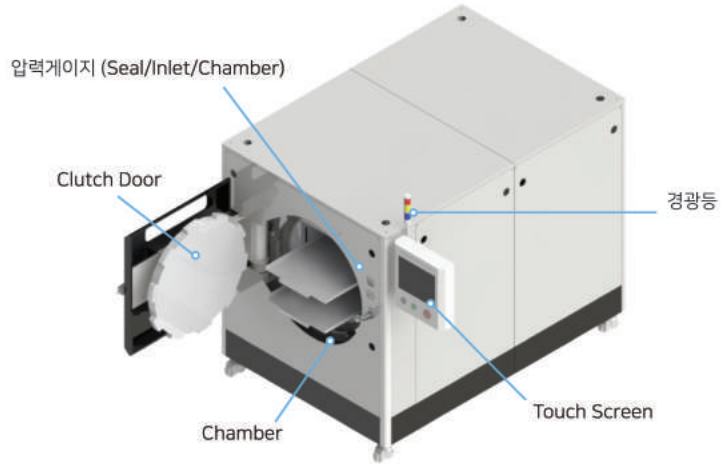


공정에 맞는 압력과 온도를 제어하는 설비로 적층 성형 공정에 적용합니다.

- 1 압력과 온도에 의한 기포 제거
- 2 온도에 의한 경화 작업
- 3 압력에 의한 접착력 강화



필름 접합 (FA)



유리 접합 (GA)



반도체 패키징 공정 (HA)

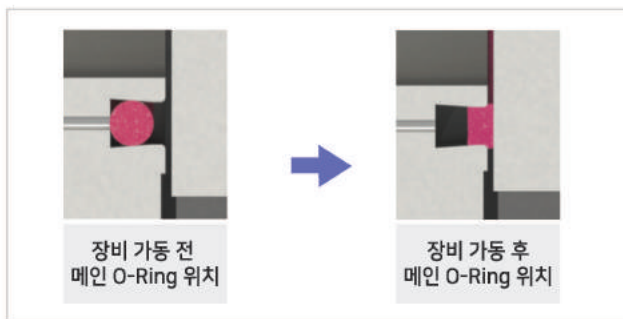


가압오븐의 구성



가압오븐의 특징점

■ 메인 O-ring



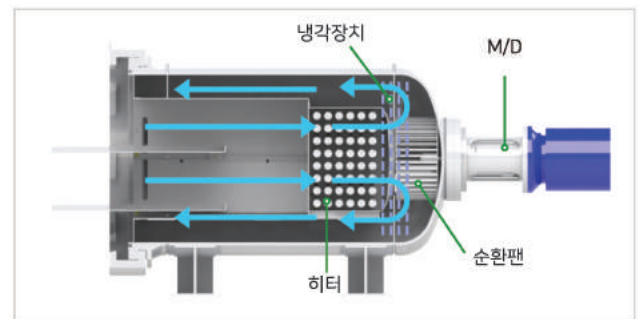
- 1 O-Ring 수명 연장
- 2 온도에 맞는 재질 선정
- 3 이물의 발생 없음

■ 업계 최고의 기술력



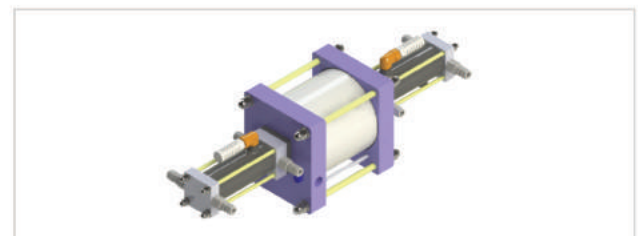
2011 산업기계 안전대상 장려상 수상
[LCD패널 결함(Void)제거 장치]

■ 내부흐름



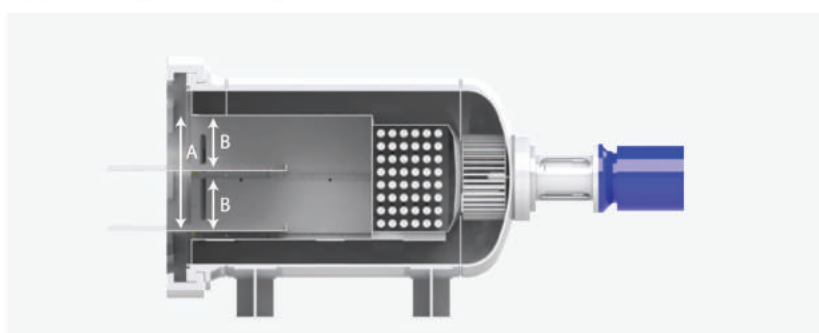
- 1 온도 편차 : ±3℃ 이내
- 2 온도제어 : Convection Type 순환방식
- 3 공간 활용 : 불필요한 공간을 이용하여 냉각장치 구성

■ Booster



- 1 자회사인 '펌스터' 제품으로 신속 대응 가능
- 2 컴프레서에 비해 작은 공간으로 설치 가능
- 3 컴프레서에 비해 저렴한 가격
- 4 탁월한 내구성

가압오븐 선정 시 고려 사항



- 1 사이즈 (A, B)
- 2 압력
- 3 온도
- 4 냉각
- 5 가압장치 (Booster or Compressor)
- 6 가압매체 (Air or Gas)